

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、新製品の研究開発、生産能力の拡大、品質の向上、事務の効率化などを図るべく、設備の拡充・改良並びに更新を進めており、当連結会計年度におきましては、需要が急増している半導体をはじめとする成長分野に重点的に4,380億円の設備投資を行いました。

その主要なものとしたしましては、ソフトウェア・サービス関係では、ネットワークサービスビジネスにおけるアウトソーシング設備、ネットワーク基盤設備の増強を行い、650億円を投資いたしました。

情報処理関係では、UNIXサーバ開発設備を増強し、549億円を投資いたしました。

通信関係では、光伝送システム及び次世代移動通信システムの開発・製造設備を増強し、442億円を投資いたしました。

電子デバイス関係では、フラッシュメモリ製造設備、最先端ロジックIC開発ライン及び化合物半導体量産設備の増強並びにあきる野テクノロジーセンターの開設に、2,492億円を投資いたしました。

上記セグメント以外では、電子事業及び電池事業の増産、合理化、省力化設備を増強し、122億円を投資いたしました。

なお、設備投資額については、当社の一般管理部門及び共通研究等の各セグメントに配賦できない設備投資額125億円が含まれております。

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) ソフトウェア・サービス

平成13年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物	機械装置	その他	合計		
提出会社	幕張システムラボラトリ (千葉県美浜区)	システム開発 設備	3,708 (14)	13,843	87	2,360	19,999	1,189
	情報処理システムラボラトリ (東京都大田区)	システム開発 設備	1,110 (24)	5,201	8,753	3,874	18,939	1,328
	館林システムセンタ (群馬県館林市)	アウトソーシ ング設備	1,913 (126)	8,535	222	8,623	19,294	312
在外子 会社	ICL PLC (イギリス他) (注4.)	システム開発 設備及びアウト ソーシング 設備	1,228 (200)	2,886	3,613	35,160	42,887	20,261 [2,641]

(2) 情報処理

平成13年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物	機械装置	その他	合計		
提出会社	長野工場 (長野県長野市)	磁気ディスク 装置製造設備	920 (105)	11,156	15,024	7,780	34,881	2,564
	沼津工場 (静岡県沼津市)	コンピュータ 製造設備	3,765 (550)	11,032	599	8,068	23,466	1,667
国内子 会社	(株)PFU笠島工場 (石川県河北郡宇ノ気町)	情報処理シス テム製造設備	192 (138)	2,427	592	474	3,685	491
	(株)島根富士通本社 (島根県簸川郡斐川町)	パーソナルコ ンピュータ製 造設備	0 (98)	2,851	1,101	669	4,622	420
在外子 会社	Amdahl Corporation (米国他) (注5.)	情報処理シス テム開発、製 造設備	294 (33)	2,261	2,974	3,688	9,217	10,388
	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カーメルレイ工場 (フィリピン)	磁気ディスク 装置製造設備	0 (284)	5,625	34,791	532	40,948	9,025
	Fujitsu (Thailand) Co.,Ltd ナバナコン工場 (タイ)	磁気ディスク 装置製造設備	887 (212)	3,714	9,732	4,039	18,372	7,505

(3) 通信

平成13年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物	機械装置	その他	合計		
提出会 社	小山工場 (栃木県小山市)	デジタル 交換機及び 光伝送シス テム製造設 備	982 (218)	7,748	5,717	12,705	27,153	3,011
	那須工場 (栃木県大田原市)	移動通信シ ステム製造 設備	1,250 (184)	3,619	1,576	6,173	12,620	702
在外子 会社	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場 (米国テキサス州)	光伝送シス テム製造設 備	3,842 (760)	10,299	2,373	16,940	33,454	3,784 [1,746]

(4) 電子デバイス

平成13年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
			土地 (面積千㎡)	建物	機械装置	その他	合計	
提出会社	三重工場 (三重県桑名郡多度町)	半導体製造設備	4,327 (307)	17,338	19,146	4,709	45,521	1,433
	岩手工場 (岩手県胆沢郡金ヶ崎町)	半導体製造設備	2,881 (290)	11,417	24,265	6,865	45,428	1,997
	会津若松工場 (福島県会津若松市)	半導体製造設備	3,432 (369)	7,589	22,595	4,994	38,612	1,623
	あきる野テクノロジセンター (東京都あきる野市)	電子デバイスに関する研究開発設備	12,756 (121)	5,771	3,082	3,796	25,406	1,768
国内子会社	富士通イー・エム・ディ・セミコンダクタ(株)本社 (福島県会津若松市)	フラッシュメモリ製造設備	0 (62)	12,006	47,960	1,350	61,316	1,442
	富士通クアンタムデバイス(株)本社 (山梨県中巨摩郡昭和町)	化合物半導体製造設備	934 (107)	5,646	5,925	5,266	17,771	1,020
	新光電気工業(株)高丘工場 (長野県中野市)	半導体パッケージ製造設備	2,109 (97)	3,926	6,030	5,020	17,085	1,061
在外子会社	Fujitsu Microelectronics, Inc. グレシャム工場 (米国オレゴン州)	半導体製造設備	1,115 (809)	18,473	5,873	371	25,833	864

(5) 共通

平成13年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
			土地 (面積千㎡)	建物	機械装置	その他	合計	
提出会社	川崎工場 (川崎市中原区)	ソフトウェア、情報処理システム及び通信システムに関する研究開発設備	3,463 (175)	19,194	1,580	40,943	65,181	8,848
国内子会社	(株)富士通研究所 厚木研究所 (神奈川県厚木市)	ソフトウェア、情報処理システム、通信システム及び電子デバイスに関する研究開発設備	0 (19)	4,736	6,345	2,815	13,898	649

- (注) 1. 投下資本は期末帳簿価額によります。ただし、建設仮勘定を除きます。
2. 投下資本のその他とは構築物、車両及び運搬具並びに工具器具及び備品であります。
3. ICL PLC及びAmdahl Corporationの数値は、各社の連結決算数値であります。
4. 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は5,391百万円であります。
5. ソフトウェア・サービス事業を一部含んでおります。また、建物の一部を賃借しており、年間賃借料は3,172百万円であります。

6. (株)島根富士通、富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ(株)及び(株)富士通研究所の土地はすべて当社から賃借しているものであります。
7. Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippinesの土地はすべてFujitsu Development Corporation of the Philippinesから賃借しているものであります。
8. 従業員数の〔 〕は、臨時従業員数を外書しております。
9. 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

(4)電子デバイス

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	賃借料又はリース料
在外子会社	Fujitsu Microelectronics, Inc. グレシャム工場 (米国オレゴン州)	半導体製造設備	年間リース料 16,678百万円

3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ(当社及び連結子会社)の当連結会計年度後1年間の設備投資計画(新設・拡充)は、4,800億円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	平成13年3月末計画額 (百万円)	設備等の主な内容・目的
ソフトウェア・サービス	75,000	アウトソーシング関連設備、ネットワーク基盤設備等の更新及び拡充
情報処理	70,000	磁気ディスク装置、グローバルサーバ及びUNIXサーバの製造設備、研究開発設備等の更新及び拡充
通信	50,000	次世代移動通信システムの製造設備、研究開発設備等の更新及び拡充
電子デバイス	260,000	フラッシュメモリ、ロジックIC及びプラズマディスプレイパネルの製造設備、研究開発設備等の更新及び拡充
金融	-	-
その他	15,000	電子材料及び電池の製造設備等の更新及び拡充
全社(共通)	10,000	-
計	480,000	-

(注) 1. 今後の所要資金480,000百万円は、自己資金により充当する予定であります。

2. 設備投資の計画額は、消費税等抜きで表示しております。
3. 経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。
4. 全社(共通)は、当社の一般管理部門及び共通研究等のセグメント配賦不能な設備投資額であります。
5. 各セグメントの計画概要は次のとおりであります。

ソフトウェア・サービス関係につきましては、アウトソーシング設備関連投資を中心に、当社単独で300億円及び連結子会社で450億円であります。

情報処理関係につきましては、磁気ディスク用ヘッドの開発・製造設備、グローバルサーバ及びUNIXサーバの開発・製造設備関連投資を中心に、当社単独で300億円及び連結子会社で400億円であります。

通信関係につきましては、次世代移動通信システムの開発・製造設備関連投資を中心に、当社単独で300億円及び連結子会社で200億円であります。

電子デバイス関係につきましては、フラッシュメモリ製造設備関連投資1,100億円、ロジックIC開発・製造設備関連投資500億円、プラズマディスプレイパネル製造設備関連投資230億円等であります。

上記セグメント以外につきましては、電子材料及び電池等の製造設備関連投資73億円等であります。